

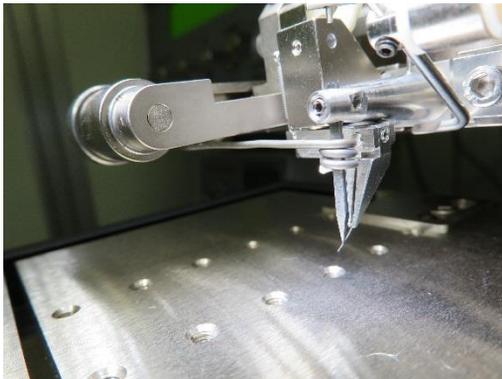
加工 (後工程装置群)

ワイヤボンダ

WEST・BOND社製 Model 7KE

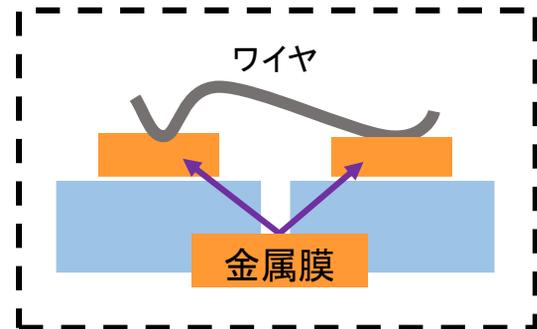
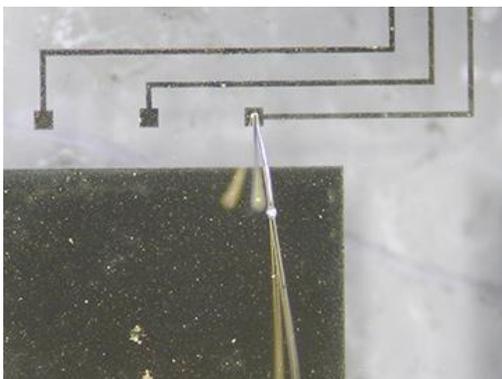
仕様

ワイヤ材質	AL、Au
ワイヤサイズ	$\phi 40 \mu\text{m}$
周波数	63kHz
ボンダツール	45° ワイヤフィード 90° ディープアクセス ボールボンダ (Au配線のみ)



自由度の高い微細配線

超音波熱圧着マルチワイヤーボンダーです。ボンダツールは3種類用意しており、デバイスに応じて取り換え可能です。ボンダツール毎にボンディング条件を30個まで記録させることが出来る為、一度条件を出してしまえば、誰でも簡単にボンディング可能になります。



「文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業」

微細加工プラットフォーム ・ 香川大学



お問い合わせ先

香川大学 産学連携・知的財産センター
ナノテクノロジー支援室

TEL/FAX: 087-887-1873

E-mail: nanoplatform-c@kagawa-u.ac.jp

